(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月9日(09.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/211117 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01) *H01L 25/07* (2006.01)
C09J 11/08 (2006.01) *H01L 25/18* (2023.01)
C09J 163/00 (2006.01) *H01L 25/065* (2023.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/009021

(22) 国際出願日： 2025年3月11日(11.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-059759 2024年4月2日(02.04.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 (JP).

(72) 発明者: ▲ 桑 ▼ 原 惇 (**KUWAHARA Jun**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 (JP).

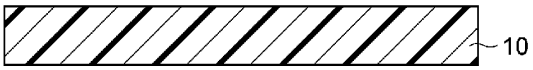
(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外 (**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) **Title:** ADHESIVE FILM FOR SEMICONDUCTOR, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, DICING DIE-BONDING INTEGRATED FILM, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称： 半導体用接着フィルム及びその製造方法、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、並びに半導体装置の製造方法



(57) **Abstract:** Disclosed is an adhesive film for a semiconductor. This adhesive film for a semiconductor contains an epoxy resin, a phenol resin, and a modified elastomer. The modified elastomer is a reaction product of a phenol resin and an elastomer having an epoxy group. The adhesive film for a semiconductor may be used in order to body a semiconductor chip to a substrate while burying another semiconductor chip. The adhesive film for a semiconductor may be used in order to bond a semiconductor chip to another semiconductor chip while burying a portion or the entirety of a wire that is connected to the other semiconductor chip.

(57) 要約：半導体用接着フィルムが開示される。当該半導体用接着フィルムは、エポキシ樹脂と、フェノール樹脂と、変性エラストマーとを含有する。変性エラストマーは、エポキシ基を有するエラストマーとフェノール樹脂との反応生成物である。当該半導体用接着フィルムは、半導体チップを、他の半導体チップを埋め込みながら基板に接着するために用いられるものであってよい。当該半導体用接着フィルムは、半導体チップを、他の半導体チップに接続されたワイヤの一部又は全体を埋め込みながら他の半導体チップに接着するために用いられるものであってよい。

WO 2025/211117 A1

［続葉有］

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）